

ミヤマの半導体研磨工程の排水処理技術

シリコン系・ガリウムヒ素系等に対応できます。

概要

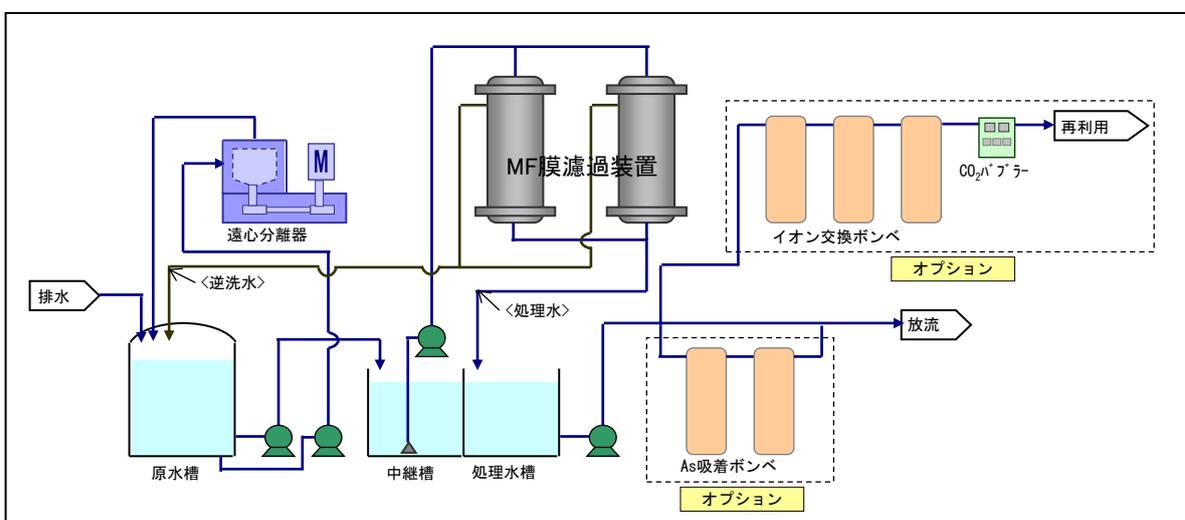
半導体のバックグラインダー、ダイシング、CMP工程の排水をろ過処理するシステムです。
MF膜を使用することで、薬品を使用しませんのでランニングコストの低減に貢献します。

特徴

- MF膜を使用しています。
- セラミック膜と有機膜の二種類が選択可能です。
- 目詰まりした膜は、弊社の工場で再生して返却することが可能です。
- ガリウムヒ素材を使用する工程では、ヒ素がイオン化しますが、オプションでイオン交換等を併設すれば処理可能となります。飽和したイオン交換ポンベは弊社で再生し返却致します。
- 排水を再利用する場合はイオン交換ポンベとCO₂バブラーをオプションで併設すれば可能です。飽和したイオン交換ポンベは弊社で再生し返却致します。

フローシート

(下記は一例です、ご希望により最適な提案をさせていただきます。)



ミヤマ株式会社 環境装置事業部 〒381-2283 長野県長野市稲里一丁目5番地3
TEL026-285-4183 FAX026-285-3551 E-mail:souchi@miyama.net http://www.miyama.net